

■適用下地及び下地処理

〈石膏プラスターボード〉

- 石膏プラスターボードは突き付け貼りし、取り付け釘はステンレス製のものをご使用ください。
- 平ボード、ベベルボード、テーパーボード等のジョイント及び出隅、入隅にはテープ状の寒冷紗貼り、パテ処理、ペーパー処理をし平滑に調整してください。

※仕上げパテは必ずベージュ色樹脂系パテを使用してください。石膏系パテは塗面の浮き等の原因になります。

例：仕上げパテ タイガージョイントセメント ペーストタイプ（吉野石膏製）等

〈コンパネ等木系下地〉

- 石膏プラスターボードと同様のジョイント処理後、全面をアク止め水系シーラー（アクドメール）を塗布してください。

〈ケイカル板下地〉

- ケイカル板を突き付け貼りをし、石膏プラスターボードと同様のジョイント処理後、全面に水引き調整用シーラー（シーラー W 等）を塗布してください。

〈コンクリート打放し〉

- コンクリート打放し面は、事前に凸部のサンダー処理及び凹部（段違い、ジャンカ巣穴及びコーナーの欠損部等）の樹脂モルタル補修後、全面を樹脂モルタルまたはセメントフィラーで補修してください。

※セメントフィラー等、セメント分が多いものを使用した場合、エフロレッセンスが出る可能性があります。

乾きの遅い場合やエフロが出る恐れのある場合は、セメントフィラー施工後にシーラー W を塗布し、充分乾燥させてください。

- 充分な乾燥時間をとってください。（含水率：10% 以下）

〈モルタル〉

- モルタルは木ゴテで整え、金ゴテで押さえて仕上げてください。

※軽量モルタルを使用した場合、エフロレッセンスが出る可能性があります。乾きの遅い場合やエフロが出る恐れのある場合は、軽量モルタル施工後にシーラー W を塗布し、充分仮想させてください。

- 充分な乾燥時間を取ってください。（含水率 10% 以下）

〈アンダーペーパー MT〉

- アンダーペーパーに付着した糊などは除去してください。

※アンダーペーパーの上に塗布した場合は、不燃認定の対象ではありません。

■養生

- 施工面以外に材料が付着しないように養生テープ、ビニール等で充分に養生してください。

（その際、施工面から数 mm 逃げて養生してください。）

- ペイント塗装面等は、粘着力の小さなテープで捨貼りして養生してください。

■材料の調整

- 下塗り及び上塗りに使用するエッグペイントは、適量の水を加え、ハンドミキサー等で充分に攪拌して使用してください。

■施工

- 調整したエッグペイントを、ウールローラー等で均一に塗布してください。

（塗布量：2回塗り 0.4kg/ m²）1回あたり 0.2kg/ m²



〈標準仕様〉 ロール工法

工程	材料	調合 (重量比)	塗布量 (kg/ m ²)	塗り回数	間隔時間 (h)※1		
					工程内	工程間	最終養生
1	エッグペイント	18kg	0.4	2	2 以上		24 以上
	清水	0~200cc	-				

※1 工程間間隔は、標準時（20℃・65%）を想定

■使用材料

- ・エッグペイント・・・18kg/ 缶 (2回塗り 約 45 m²、1回塗り 約 90 m²)
4kg/ 缶 (2回塗り 約 10 m²、1回塗り 約 20 m²)

※水分量、塗布量を遵守してください。特にホワイトは下地が透ける恐れがありますのでご注意ください。

■注意事項

- ・施工時の気温が5℃以下、湿度が85%以上、結露が考えられる場合は施工しないでください。
- ・施工に際しては、風や直射日光を防ぐためにシート養生を行い、施行準備をしてください。
- ・材料は凍結、直射日光を避けて保管してください。
- ・使用した器具は乾燥しないうちに水洗いしてください。

※アンダーペーパーの上に塗布した場合は、不燃認定の対象ではありません。

詳しくはお問い合わせください。

〈下地等に関する注意〉

- ・下地は十分に乾燥していることが必要です。
- ・石膏ボード等のジョイント処理は、仕上材が薄膜のため段差が出来ないように平滑に仕上げてください。
- ・錆の出る恐れがある箇所にはアク止めをしてください。
- ・下地の汚れ（レイタンス・油分等）は完全に除去してください。
- ・欠損部は樹脂モルタル等で部分補修してください。
- ・シーリング部の上も合わせて施工する場合、シーリング材の種類としてはノンブリードタイプのシーリング材のご使用をお勧めします。
- ・下地にアンダーペーパー MT をご使用の際は、アンダーペーパー MT の施工要項に従って施工してください。

NIHONMTECS

〈お問い合わせ〉

日本エムテクス株式会社
東京都世田谷区駒沢 2-16-18-3F
03-5433-3450 info@nmtecs.jp

